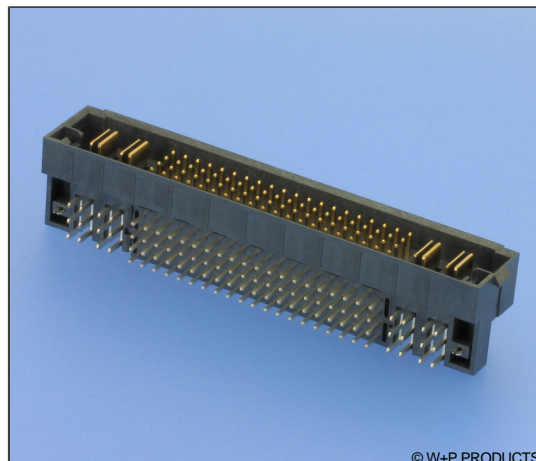


## Power-Signal-Terminal RM 5,00/2,00mm, Stiftkontakte, gewinkelt Power-Terminal 5.00mm Pitch, Male, Right-angled

### Technische Daten / Technical Data

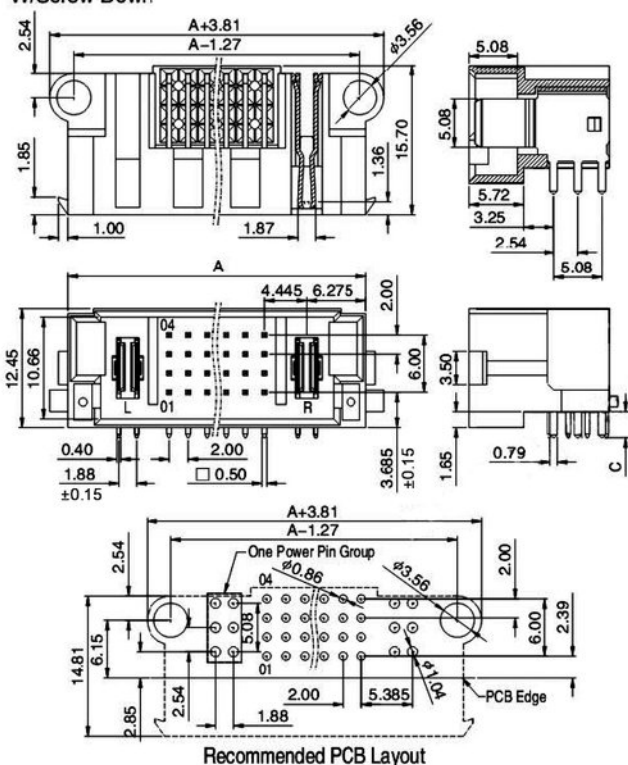
Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to plating options, over Ni
Nennspannung	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Voltage Rating	Power: 600 V AC / 848 V DC Signal: 300 V AC / 424 V DC
Nennstrom	Power: 24,7 A / Signal: 1 A
Current Rating	Power: 24.7 A / Signal: 1 A
Temperaturbereich	-55° ... +105° C
Temperature Range	-55° ... +105° C
Verarbeitung	260°C für 10s
Processing	260°C for 10s



© W+P PRODUCTS

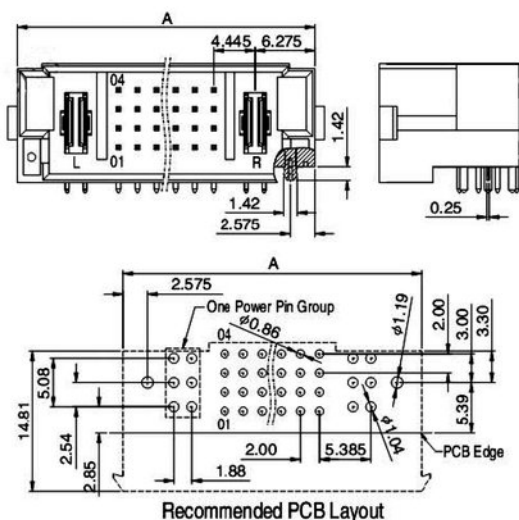
inectors :  
6 (24/80)

#### W/Screw Down



#### W/Locking Clip

Power Pins/End	A	
	24 Signal Pins	80 Signal Pins
01	31.44	59.44
02	41.44	69.44



Series	Power Left*	Signal*	Power Right*	Terminals*	Plating (Power)*	Plating (Signal)*	Board Locks*	Packaging*
<b>457</b>	<b>01</b>	<b>80</b>	<b>01</b>	<b>21</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>20</b>	<b>ST</b>
	01 02 Contacts	24 80 Contacts	01 02 Contacts	20 C=2.72mm 21 C=3.52mm 22 C=4.32mm	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	00 Au flash 50 Sn 60 Sel. Au/Sn 610 Sel. Au 10µ"/Sn	20 Locking Clips 30 Screw down	ST TRAY

\* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an order example - please replace by your specifications.

#### Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes  
TRAY Auf Tray / On tray

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

